



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > DIMM 插槽



DRAM 类型: 标准

位数: 72

PCB 端接方法: 表面贴装

模块方向: 直角

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
DRAM 类型	标准

结构特性

钥匙数	1
行数	2
位数	72
模块方向	直角

电气特征

DRAM 电压	3.3 V
---------	-------

主体特性

固定柱位置	无
插销材料	铜合金
连接器外形	标准
弹射器位置	两端
弹射器材料	铜合金
弹射器类型	锁定

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 μm[78.7 μin]
端子底板材料	镍
插座种类	M3（小型内存模块）



端子接触部电镀材料	镀金
内存插槽类型	内存卡
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子接合区域电镀材料厚度	.3 μm[11.81 μin]

端接特性

插入种类	凸轮
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

安装角度	直角
接合对准类型	无
接合对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准类型	定位柱

壳体特性

外壳材料	LCP
壳体颜色	土黄色
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

PCB 的外形高度	5.5 mm[.21 in]
行间距	5.2 mm[.2 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	35
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）

超过限值的SVHC：

Pb (13% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

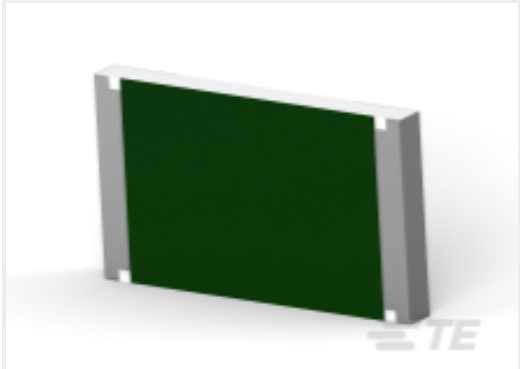
焊接工艺能力

回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

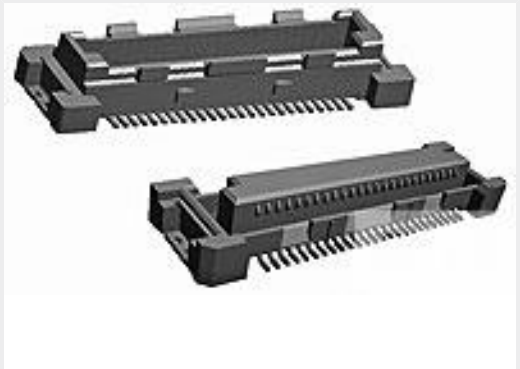
客户还购买了



TE 产品编号2176406-9
3560 2R2 1%



TE 产品编号NB18922001
RNF-100-1/16-YO-STK



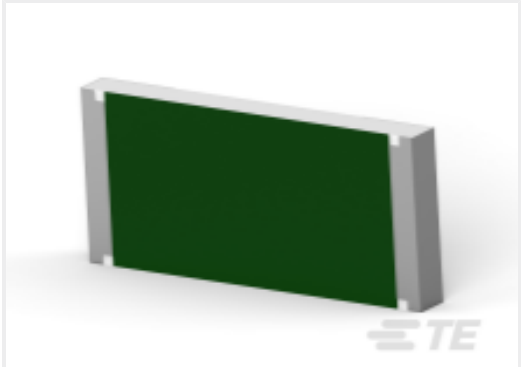
TE 产品编号1-5353729-0
.6FHR04H,280,B,GIG,08/Sn,ST,NSYes



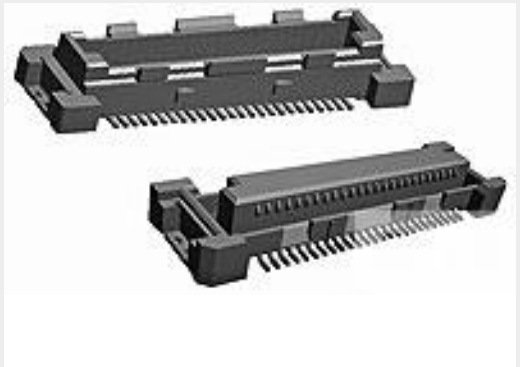
TE 产品编号1-1879128-4
RN 0402 604R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号2118721-4
STD SHIELD COVER, AL-38.60X25.90X2.00MM



TE 产品编号2176403-2
3550 1R1 1%



TE 产品编号1-5353727-0
.6FHP08H,280,B,GIG,08/Sn,ST,NSYes



TE 产品编号2085958-1
ICCON,SIZE 4,LOCKING PIN ASSEMBLY



文档

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_177827-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_177827-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_177827-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

AMP MIII Socket (Mini Memory Module Socket)

英文版本

AMP MIII Socket (Mini Memory Module Socket)

日语

产品规格

日语

机构认证

UL 报告

英文版本